

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第4270891号  
(P4270891)

(45) 発行日 平成21年6月3日(2009.6.3)

(24) 登録日 平成21年3月6日(2009.3.6)

(51) Int.Cl.

F 1

<b>H05B</b>	<b>33/10</b>	<b>(2006.01)</b>	H05B	33/10
<b>H01L</b>	<b>51/50</b>	<b>(2006.01)</b>	H05B	33/14
<b>G09F</b>	<b>9/30</b>	<b>(2006.01)</b>	G09F	9/30
<b>H01L</b>	<b>27/32</b>	<b>(2006.01)</b>		365Z

A

請求項の数 3 (全 7 頁)

(21) 出願番号

特願2003-12381 (P2003-12381)

(22) 出願日

平成15年1月21日 (2003.1.21)

(65) 公開番号

特開2004-227852 (P2004-227852A)

(43) 公開日

平成16年8月12日 (2004.8.12)

審査請求日

平成17年12月27日 (2005.12.27)

(73) 特許権者 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(74) 代理人 100107906

弁理士 須藤 克彦

(74) 代理人 100091605

弁理士 岡田 敏

(72) 発明者 西川 龍司

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

(72) 発明者 永田 良三

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三

洋電機株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 EL表示装置のレーザーリペア方法

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

複数の画素を備え、前記画素毎に、アノード層とカソード層の間にEL層が介在されて成るEL素子を有するEL表示装置のレーザーリペア方法において、前記EL素子に付着した異物を検出し、この異物の周辺領域にレーザー照射を行うことにより、前記異物に直接前記レーザー照射をすることなく、前記異物が付着した画素のアノード層とカソード層との間に高抵抗領域を形成することを特徴とするEL表示装置のレーザーリペア方法。

## 【請求項 2】

前記異物の周辺領域にレーザー照射を複数回行うことと特徴とする請求項1記載のEL表示装置のレーザーリペア方法。

10

## 【請求項 3】

前記レーザー照射によるレーザーの波長が532nm以下であることを特徴とする請求項1又は請求項2記載のEL表示装置のレーザーリペア方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

## 【発明の属する技術分野】

本発明は、複数の画素を備え、各画素毎に、アノード層とカソード層の間にEL層が介在されて成るEL素子を有するEL表示装置のレーザーリペア方法に関する。

## 【0002】

## 【従来の技術】

20

近年、有機エレクトロルミネッセンス (Electro Luminescence: 以下、「有機 E L」と称する。) 素子を用いた有機 E L 表示装置が、C R T や L C D に代わる表示装置として注目されている。

【 0 0 0 3 】

図 5 は、係る有機 E L 素子の構造を示す断面図である。ガラス基板等の透明絶縁基板 10 上に、I T O から成るアノード層 (ANODE) 1 が形成され、この上にホール輸送層 (HTL) 2 、発光層 (EML) 3 及び電子輸送層 (ETL) 4 から成る有機 E L 層が積層され、さらに、この有機 E L 層上にカソード層 (CATHODE) 5 が形成されている。アノード層 1 とカソード層 2 の間に電位差を加え、この有機 E L 素子に駆動電流を流すと、アノード層 1 から注入されたホールと、カソード層 5 から注入された電子とが発光層 3 の内部で再結合し、発光層 3 を形成する有機分子を励起して励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層 3 から光が放たれ、この光が透明なアノード層 1 から透明絶縁基板を介して外部へ放出されて発光する。

【 0 0 0 4 】

上記の有機 E L 層及びカソード層 5 はメタルマスクを用いた蒸着法により形成される。この蒸着工程で、図 6 に示すように異物 6 が有機 E L 素子の形成領域に付着することがある。このため、アノード層 1 とカソード層 5 との間でショートが発生し、アノード層 1 とカソード層 5 との間の電位差がなくなってしまう。すると、有機 E L 素子に駆動電流が流れなくなり、画素領域にいわゆるダークスポット (滅点) が発生する。

【 0 0 0 5 】

そこで、所定の波長 (例えば、1 0 5 6 nm) を有するレーザー光をこの異物 6 に照射し、異物を焼き切ってしまい、これにより、レーザー照射を行った画素を除き、周辺画素領域が正常に発光するようにしていた。

なお、関連する先行技術文献としては、以下の特許文献 1 がある。

【特許文献 1】

特開 2 0 0 0 - 1 9 5 6 7 7 号公報

【 0 0 0 6 】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、異物 6 に対するレーザー光照射が適切に行われないと、そのエネルギーによりカソード層 5 等にダメージが加わり、それらが断裂して有機 E L 素子部分にピンホールが形成されるおそれがあった。このピンホールが形成されると、そこから水分が素子内部に浸入して素子特性の劣化が起こり、ダークスポットという表示不良が発生する。

【 0 0 0 7 】

そこで、本発明は係るピンホールの発生を抑止した E L 表示装置のレーザーリペア方法を提供することを目的とする。

【 0 0 0 8 】

【課題を解決するための手段】

本発明の E L 表示装置のレーザーリペア方法は、複数の画素を備え、前記画素毎に、アノード層とカソード層の間に E L 層が介在されて成る E L 素子を有する E L 表示装置のレーザーリペア方法において、前記 E L 素子に付着した異物を検出し、この異物の周辺領域にレーザー照射を行うことにより、前記異物に直接前記レーザー照射をすることなく、前記異物が付着した画素のアノード層とカソード層との間に高抵抗領域を形成することを特徴とするものである。

【 0 0 0 9 】

本発明によれば、異物に直接レーザー照射を行うのではなく、その周辺領域にレーザー照射を行うようにした。これにより、異物が付着した有機 E L 素子にダメージが加わるのが防止される。また、異物の周辺領域にレーザー照射すれば、そのエネルギーは間接的に異物にも供給されるため、レーザー照射領域を適切に設定することで、アノード層とカソード層との間に高抵抗領域を形成することが可能となり、異物によるショート不良箇所をリペアすることができる。

10

20

30

40

50

**【0010】****【発明の実施の形態】**

次に、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。まず、本発明が適用される有機EL表示装置について説明する。図1に有機EL表示装置の画素付近を示す平面図を示し、図2(a)に図1中のA-A線に沿った断面図を示し、図2(b)に図1中のB-B線に沿った断面図を示す。

**【0011】**

図1及び図2に示すように、ゲート信号線51とドレイン信号線52とに囲まれた領域に画素115が形成されており、その画素115がマトリクス状に配置されている。

**【0012】**

この画素115には、自発光素子である有機EL素子60と、この有機EL素子60に電流を供給するタイミングを制御するスイッチング用TFT30と、有機EL素子60に電流を供給する駆動用TFT40と、保持容量56とが配置されている。

**【0013】**

両信号線51, 52の交点付近にはスイッチング用TFT30が備えられており、そのTFT30のソース33sは保持容量電極線54との間で容量をなす容量電極55を兼ねるとともに、EL素子駆動用TFT40のゲート41に接続されている。EL素子駆動用TFT40のソース43sは有機EL素子60のアノード61に接続され、他方のドレイン43dは有機EL素子60に供給される電流源である駆動電源線53に接続されている。

**【0014】**

また、ゲート信号線51と並行に保持容量電極線54が配置されている。この保持容量電極線54はクロム等から成っており、ゲート絶縁膜12を介してTFT30のソース33sと接続された容量電極55との間で電荷を蓄積して容量を成している。この保持容量56は、EL素子駆動用TFT40のゲート電極41に印加される電圧を保持するために設けられている。

**【0015】**

図2に示すように、有機EL表示装置は、ガラスや合成樹脂などから成る基板又は導電性を有する基板あるいは半導体基板等の基板10上に、TFT及び有機EL素子を順に積層形成して成る。ただし、基板10として導電性を有する基板及び半導体基板を用いる場合には、これらの基板10上にSiO<sub>2</sub>やSiNなどの絶縁膜を形成した上に第1、第2のTFT及び有機EL素子を形成する。いずれのTFTとともに、ゲート電極がゲート絶縁膜を介して能動層の上方にあるいわゆるトップゲート構造である。

**【0016】**

まず、スイッチング用TFT30について説明する。

**【0017】**

図2(a)に示すように、石英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁性基板10上に、非晶質シリコン膜(以下、「a-Si膜」と称する。)をCVD法等にて成膜し、そのa-Si膜にレーザ光を照射して溶融再結晶化させて多結晶シリコン膜(以下、「p-Si膜」と称する。)とし、これを能動層33とする。その上に、SiO<sub>2</sub>膜、SiN膜の単層あるいは積層体をゲート絶縁膜32として形成する。更にその上に、Cr、Moなどの高融点金属からなるゲート電極31を兼ねたゲート信号線51及びA1から成るドレイン信号線52を備えており、有機EL素子の駆動電源でありA1から成る駆動電源線53が配置されている。

**【0018】**

そして、ゲート絶縁膜12及び能動層33上の全面には、SiO<sub>2</sub>膜、SiN膜及びSiO<sub>2</sub>膜の順に積層された層間絶縁膜15が形成されており、ドレイン33dに対応して設けたコンタクトホールにA1等の金属を充填したドレイン電極36が設けられ、更に全面に有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜17が形成されている。

**【0019】**

次に、有機EL素子の駆動用TFT40について説明する。図2(b)に示すように、石

10

20

30

40

50

英ガラス、無アルカリガラス等からなる絶縁性基板 10 上に、a-Si 膜にレーザ光を照射して多結晶化してなる能動層 43、ゲート絶縁膜 12 及び Cr、Mo などの高融点金属からなるゲート電極 41 が順に形成されており、その能動層 43 には、チャネル 43c と、このチャネル 43c の両側にソース 43s 及びドレイン 43d が設けられている。

#### 【0020】

そして、ゲート絶縁膜 12 及び能動層 43 上の全面に、SiO<sub>2</sub> 膜、SiN 膜及び SiO<sub>2</sub> 膜の順に積層された層間絶縁膜 15 を形成し、ドレイン 43d に対応して設けたコンタクトホールに Al 等の金属を充填して駆動電源に接続された駆動電源線 53 が配置されている。更に全面に例えれば有機樹脂から成り表面を平坦にする平坦化絶縁膜 17 を備えている。  
10 そして、その平坦化絶縁膜 17 のソース 43s に対応した位置にコンタクトホールを形成し、このコンタクトホールを介してソース 43s とコンタクトした ITO から成る透明電極、即ち有機 EL 素子のアノード層 61 を平坦化絶縁膜 17 上に設けている。このアノード層 61 は各表示画素ごとに島状に分離形成されている。

#### 【0021】

有機 EL 素子 60 は、ITO (Indium Tin Oxide) 等の透明電極から成るアノード 61、MTDATA (4,4-bis(3-methylphenylphenylamino)biphenyl) から成る第 1 ホール輸送層、TPD (4,4,4-tris(3-methylphenylphenylamino)triphenylamine) からなる第 2 ホール輸送層から成るホール輸送層 62、キナクリドン (Quinacridone) 誘導体を含む Be bq2 (10-ベンゾ [h] キノリノール - ベリリウム錯体) から成る発光層 63、及び Be bq2 から成る電子輸送層 64、マグネシウム・インジウム合金もしくはアルミニウム、もしくはアルミニウム合金から成るカソード層 65 が、この順番で積層形成された構造である。  
20

#### 【0022】

なお、平坦化絶縁膜 17 上にはさらに第 2 の平坦化絶縁膜 66 が形成されている。そして、アノード層 61 上については、第 2 の平坦化絶縁膜 66 が除去された構造としている。

#### 【0023】

有機 EL 素子 60 は、アノード層 61 から注入されたホールと、カソード層 65 から注入された電子とが発光層の内部で再結合し、発光層を形成する有機分子を励起して励起子が生じる。この励起子が放射失活する過程で発光層から光が放たれ、この光が透明なアノード層 61 から透明絶縁基板を介して外部へ放出されて発光する。  
30

#### 【0024】

次に、上述した有機 EL 表示装置のレーザーリペア方法について説明する。いま、図 3 に示すように、一画素の有機 EL 素子 60 に異物 100 が付着しているのを検出したとする。図 3 は断面図で見れば、図 6 と同様である。異物検出方法としては、例えば顕微鏡による目視観察や、異物検査装置による自動検出方法を採用することができる。

#### 【0025】

そこで、本発明では異物 100 に直接レーザー照射を行うのではなく、その周辺領域に照射領域 111 を設定してレーザー照射を行うようにした。これにより、異物 100 が付着した有機 EL 素子 60 にダメージが加わり、ピンホールが発生することが防止される。また、異物 100 から離れた周辺領域にレーザー照射すれば、そのエネルギーは照射領域 111 を中心に同心円状に伝達され、間接的に異物 100 にも供給される。したがって、レーザーの照射領域 111 を図中の破線で囲まれた高抵抗化領域 112 に設定することで、アノード層 61 とカソード層 65との間に高抵抗領域を形成することが可能となり、異物 100 によるショート不良箇所をリペアすることができる。レーザー光照射により高抵抗領域が形成されるのは、レーザー光の熱エネルギーにより、ホール輸送層 2、発光層 3 及び電子輸送層 4 の各層が溶け合い、層構造が消失するためと考えられる。  
40

#### 【0026】

ここで、レーザーは例えば市販の YAG レーザー（例えはレーザー波長 355 nm）を用いることができ、その照射領域 111 の大きさは例えば 5 μm × 5 μm である。また、異物 100 のサイズは 0.3 μm ~ 10 μm である。照射領域 111 は、異物 100 から 50

$\mu\text{m} \sim 10\text{ }\mu\text{m}$ 離れていることが望ましい。

【0027】

また異物100のサイズが $3\text{ }\mu\text{m}$ 以上の場合には、図4に示すように、異物100の上下左右の周辺領域に4回レーザー照射(図中の1~4)を行い、異物領域に十分なエネルギーを供給することが好ましい。その回数は、異物100のサイズの大小により適宜増減することができる。

【0028】

なお、照射するレーザーの波長は、 $532\text{ nm}$ 以下の波長であれば、有機EL素子にダメージを与えることなくリペアが可能である。

【0029】

10

【発明の効果】

本発明のEL表示装置にレーザーリペア方法によれば、異物に直接レーザー照射を行うのではなく、その周辺領域にレーザー照射を行うようにしたので、ピンホールによるダークスポットの発生を招くことなく、ショート不良箇所をリペアすることができる。これにより、表示不良を救済することで、EL表示装置の歩留まりを向上することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用されるEL表示装置の平面図である。

【図2】本発明が適用されるEL表示装置の平面図である。

【図3】本発明の実施形態に係るEL表示装置のレーザーリペア方法を説明する平面図である。

20

【図4】本発明の実施形態に係るEL表示装置のレーザーリペア方法を説明する平面図である。

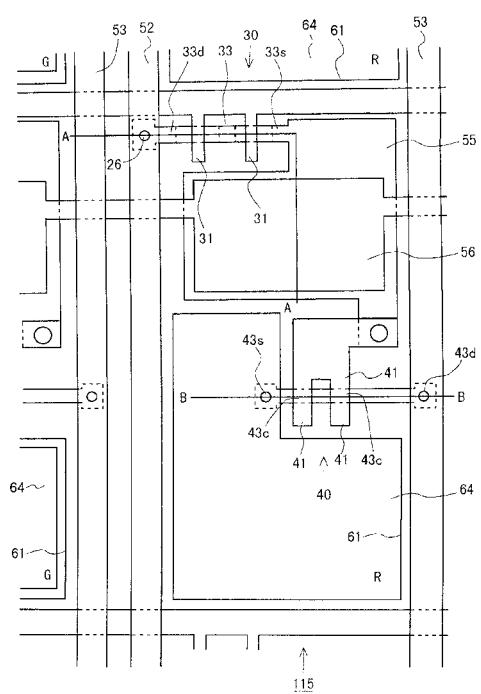
【図5】従来例に係る有機EL素子の断面図である。

【図6】従来例に係る有機EL素子の断面図である。

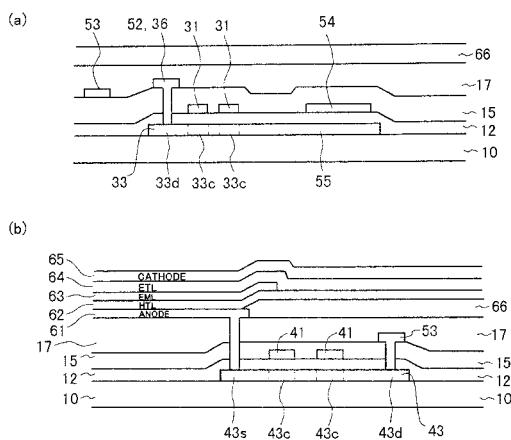
【符号の説明】

60 有機EL素子 100 異物 111 照射領域 112 高抵抗化領域

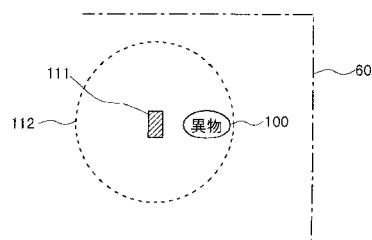
【図1】



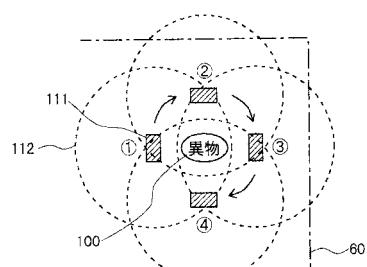
【図2】



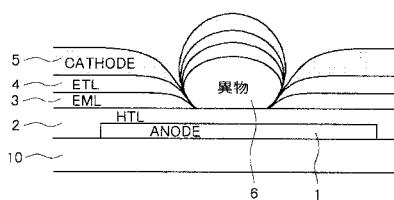
【図3】



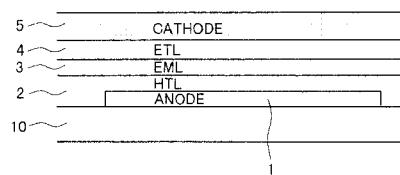
【図4】



【図6】



【図5】



---

フロントページの続き

(72)発明者 小川 隆司  
大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社内

審査官 濱野 隆

(56)参考文献 特開2002-260857(JP,A)  
特開2002-144057(JP,A)  
特開2000-208252(JP,A)  
特開2003-272844(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

H05B 33/10  
G09F 9/30  
H01L 27/32  
H01L 51/50

专利名称(译)	EL显示器件的激光修复方法		
公开(公告)号	<a href="#">JP4270891B2</a>	公开(公告)日	2009-06-03
申请号	JP2003012381	申请日	2003-01-21
[标]申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
当前申请(专利权)人(译)	三洋电机株式会社		
[标]发明人	西川龍司 永田良三 小川隆司		
发明人	西川 龍司 永田 良三 小川 隆司		
IPC分类号	H05B33/10 H01L51/50 G09F9/30 H01L27/32 G09G3/00 H01L51/56		
CPC分类号	G09G3/006 H01L51/56 H01L2251/568		
FI分类号	H05B33/10 H05B33/14.A G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K007/AB11 3K007/AB18 3K007/BA06 3K007/DB03 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC27 3K107/CC45 3K107/FF13 3K107/GG28 3K107/GG57 5C094/AA32 5C094/AA42 5C094/AA43 5C094/BA03 5C094/BA27		
代理人(译)	須藤克彦 岡田 敬		
审查员(译)	浜野隆		
其他公开文献	<a href="#">JP2004227852A</a>		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

**摘要(译)**

要解决的问题：修复短路部件而不会因针孔造成黑点。解决方案：通过在污染物100的周边区域中设置照射区域111来执行激光照射。在污染物100被粘附的情况下对有机EL元件造成损坏，从而防止产生针孔。当用激光照射与污染物100分离的周边区域时，其能量在照射区域111周围同心地传播，并间接地供应到污染物100.由此，可以在阳极层61和周围形成高电阻区域。阴极层65和由于污染100引起的短路故障部分可以修复。ž

